

 Smart Sensing 2026



SEMISOL 2026

半導体後工程技術&ソリューション展

2026年6月10日(水)～12日(金)10:00-17:00 東京ビッグサイト西3ホール

開催結果報告書

主催

Jtb Communication Design

想像を超えた、創造を。Best Solution, Best Partner.

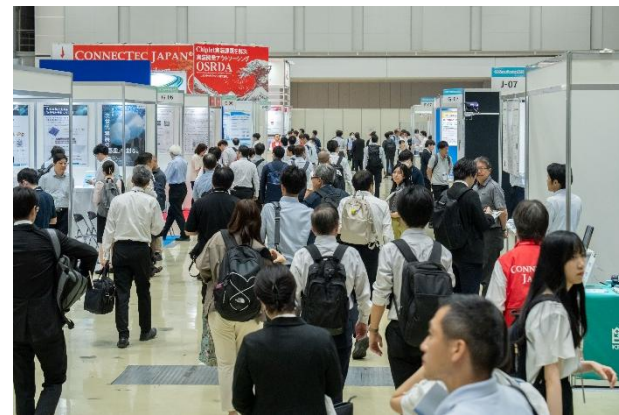
成長市場のニーズを捉える！ センサと半導体後工程の最先端技術の専門展示会を同時開催

今回で9回目の開催となったSmart Sensingは、単なるセンサ関連製品のPRにとどまらず、近年のAI需要の急拡大に対応する技術やサービスが出展者により披露されました。

社会全体や企業活動にとってますます重要視される、データ収集や分析基盤の構築、センサ技術による自動化・省人化などへの普及・拡大へ、センサビジネスに従事される皆様のさらなる市場開拓、事業拡大を力強く後押しする機会を創出いたしました。

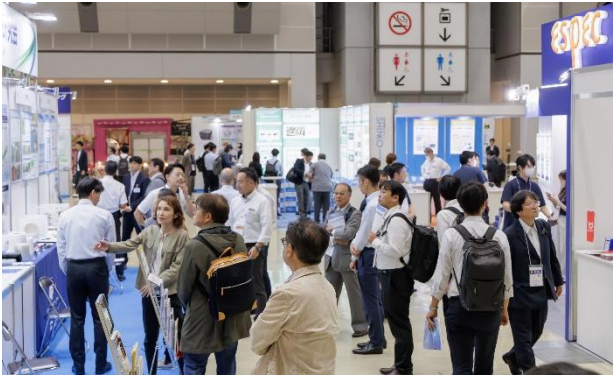
また、半導体産業の成長を牽引すると期待されている後工程は、自動運転、エッジデバイスなど高性能化のニーズの高まりや、AIの急激な進化によるサーバー、データセンターの電力需要が増加する今、AI半導体やチップレットなどの革新的技術に期待が集まっています。

SEMISOL(セミソル)半導体後工程技術&ソリューション展は、チップレットや2.5D/3Dパッケージング、光電融合、次世代材料・装置などの日本の卓越した技術力、製品開発力を後押しする展示会として、メモリ・インターポザー・基板などの分野を含む、半導体業界のさまざまな領域に従事される皆様のビジネス拡大の機会となりました。



構成 展示会	 Smart Sensing 2026  SEMISOL 2026 半導体後工程技術&ソリューション展
会 期 会 場	2026年6月10日(水)～6月12日(金)10:00-17:00 東京ビッグサイト西3ホール
主 催	株式会社JTBコミュニケーションデザイン
展示規模	64社82小間
メディア パートナー	 

来場参加者数		
4,836 名		
開催日	天候	来場者数
6月10日(水)		1,368名
6月11日(木)		1,684名
6月12日(金)		1,784名



自立電源型IoTパビリオン

振動発電デバイス、熱電モジュール、磁歪合金単結晶、エネルギーハーベスティング技術を活用した自立電源型IoTシステムなどが一堂に展示された自立電源型IoTパビリオン。環境発電技術の最先端に触れ、産学官並びに企業間のオープンイノベーションを促進する場になりました。

製品開発や実用化事例など、参画企業・大学が各技術のデモやシステム構築例、バッテリーレスIoTの社会実装に向けた最新の取り組みなどを紹介する場となりました。

■出展者：

金沢大学振動発電研究室 / 住友金属鉱山 / ヤシマ電気 / 横山商会 /
エネルギーハーベスティングコンソーシアム / リンテック

■併催セミナー：

▼センサー×振動発電：サプライチェーンから事例まで

6月10日(水)14:00 - 14:50

- ・金沢大学 先端科学・社会共創推進機構 特任助教 北 翔太 氏、高村 亜由美 氏
- ・住友金属鉱山 技術本部 材料研究所 結晶グループ グループリーダー 泉 聖志 氏
- ・ヤシマ電気 横山商会 開発部 開発1課 高田 慎一 氏

▼エネルギーハーベスティングの現在地 ～Ambient IoTの潮流～

6月10日(水)14:50 - 15:30

- ・エネルギーハーベスティングコンソーシアム / NTTデータ経営研究所 松末 竜 氏

データとAIが導く未来ゾーン

データとAIが導く未来ゾーンは、センサから取得される知能化データとAIの融合によって、新たな社会システムや革新的サービスの創出を目指す場として実施しました。プロセスインフォマティクスを活用した生産技術DX、思考拡張AIを活用した調査サービス、レザバーコンピューティング技術を活用した、音声認識・話者認識などの分野で応用されるエッジAIソリューション、実験・製造データのAI・機械学習解析クラウドサービスなどが展示され、会場では活発な商談が行われました。

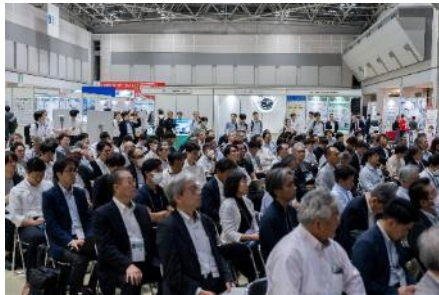
■出展者：

アイクリスタル / iFlasco / QuantumCore / データケミカル



主催者企画セミナー/出展者プレゼンテーション

開催期間中は、横浜国立大学 総合学術高等研究院 半導体量子集積エレクトロニクス研究センター 教授 井上 史大先生による基調講演を皮切りに、経済産業省によるわが国の半導体政策のほか、半導体後工程技術、チップレット実装等、最先端の半導体技術をテーマにしたSEMISOLセミナーを開催しました。また、Smart Sensingセミナーでは、フィジカルAIや手指動作・触覚センシング技術、においセンサ、振動発電などのセンサおよび周辺技術を取り上げ、専門家をお招きした講演や出展者によるプレゼンテーションを連日開催いたしました。



Synergy Stage 主催者セミナー		会場：西3ホール内	参加費：要調無料/事前登録制
		※法人格省略	
6/10 (水)	10:15-11:05	【基調講演】次世代AIを支える半導体後工程ソリューションの現在地と未来 横浜国立大学 総合学術高等研究院 半導体量子集積エレクトロニクス研究センター 教授 井上 史大 氏	
	11:20-12:10	チップレット実装の未来をひらく「受託開発・受託製造」 ー貫ビジネスモデル CADN(キャダン:Chiplet Ameba Development Network) コネクテックジャパン 代表取締役会長 平田 勝剛 氏	
	13:30-15:00	【においセンサパネルディスカッション】 においセンシングビジネスの成功事例と失敗事例 ー専門家とAIが多角的に検証ー モデレーター: 物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 グループリーダー 吉川 元紀 氏 パネリスト: Qception 代表取締役 今村 岳 氏 におい科学研究所 代表 喜多 純一 氏	
	15:15-16:00	高解像度「面センシング」で切り拓く、JDIの次世代センサー事業 ジャパンディスプレイ センサー部 部長 吉田 公二 氏	
6/11 (木)	10:15-11:05	人間拡張とフィジカルAI 人間拡張は完全自動化への過渡的技術ではない 産業技術総合研究所 フェロー 持丸 正明 氏	
	13:00-16:00	先端半導体を創る後工程技術	
	13:00-13:30	『我が国の半導体政策について』 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 デバイス・半導体戦略室 室長補佐 牧野 孝太郎 氏	
	13:30-14:40	『後工程標準化の実装フェーズへ: SATAS/パイロットライン実証の取り組み』 半導体後工程自動化・標準化技術研究組合 理事長 / 元インテル 代表取締役会長 鈴木 国正 氏 ダイワグループホーム事業部 エンジニアリング部 部長 中島 貴一 氏 平田機工 事業本部 第一ビジネスユニット 関東事業部 第一技術部 次長 中村 和弘 氏 ヤマハ発動機 ロボティクス事業部 技術統括部 先行開発部 部長 西村 啓二 氏	
6/12 (金)	15:00-15:30	『先端パッケージ向け材料開発における未来共創』 レゾナック エレクトロニクス事業本部 開発センター長 池内 孝敏 氏	
	15:30-16:00	『高信頼な車載AI半導体の後工程技術開発』 大阪大学産業科学研究所 フレキシブル3D実装協働研究所 所長 / 特任教授 菅沼 克昭 氏	
	10:30-11:30	光電融合半導体パッケージの最新動向と産業技術総合研究所の取り組み 産業技術総合研究所 光電融合研究センター センター長 天野 建 氏	
	13:00-16:00	JEITAチップレットソリューションセミナー	
6/12 (金)	13:00-13:30	『チップレットソリューションPG活動紹介』 ローム 回路技術開発部 課長 佐藤 賢央 氏	
	13:30-14:00	『システム電源の構想設計:PIのフロントローディング』 キャノン / JEITA半導体&システム開発技術サブコミティ システムフロントローディングワーキンググループ リーダー 林 靖二 氏	
	14:00-14:30	『チップレットソリューション/ハードウェアセキュリティ』 神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 教授 永田 真 氏	
	14:30-15:00	『AI・チップレット等先端半導体パッケージング構造設計の現状と課題』 大阪大学 産業科学研究所 フレキシブル3D実装協働研究所 特任研究員 吉田 浩芳 氏	
6/12 (金)	15:00-15:30	『チップレット設計標準化動向』 コジマイデザインオフィス 代表 小島 智 氏	
	15:30-16:00	『半導体システムソリューション技術委員会の今後の活動について』 東芝デバイス&ストレージ / 電子情報技術産業協会(JEITA)半導体システムソリューション技術委員会 半導体システム開発技術サブコミティ主査 橋場 義憲 氏	

Tech Stage 主催者セミナー		会場：西3ホール内	参加費：要調無料/事前登録制
		※法人格省略	
6/10 (水)	13:00-13:45	リモート管理を実現するスマートセンシング向けディジ無線通信ソリューション デザインターナショナル フィールドアプリケーションエンジニア 湯澤 貴哉 氏	
	14:00-14:50	センサー×振動発電:サブライチェーンから事例まで 金沢大学 先端科学・社会共創推進機構 特任助教 北 翔太 氏 金沢大学 高村 亜由美 氏 住友金属鉱山 技術本部 材料研究所 結晶グループ グループリーダー 泉 聖志 氏 ヤマ電気 横山商会 開発部 開発1課 高田 慎一 氏	
	14:50-15:30	エネルギーハーベスティングの現在地 ~Ambient IoTの潮流~ エネルギーハーベスティングコンソーシアム / NTTデータ経営研究所 松末 竜 氏	
	11:20-12:05	AI時代を戦い抜く電子デバイス実装技術&人材 コネクテックジャパン 代表取締役社長 中野 高宏 氏	
6/11 (木)	14:00-14:45	PFAS規制に対応するための製品分析 ー半導体分野に必要な検査視点 島津テクノリサーチ 環境事業部 分析研究センター 先端技術R&Dグループ 副グループ長 柴山 基 氏	
	15:00-15:45	新たな企業価値を生み出すフィジカルAIやヒューマノイドロボット活用の見極め方 ~中堅中小製造現場に劇的変容を促すことができるか~ ロボットメディア 代表取締役 / ロボティクス普及促進センター 理事長 小林 賢一 氏	
	13:00-13:45	CES2026と経済安全保障 ーメガトレンドの変遷と日本企業への期待ー 日本政策投資銀行 設備投資研究所 主任研究員 青木 宗 氏	
	15:00-15:45	手指動作・触覚センシング技術とAI解析 ~人の接触動作理解と次世代ロボットへの応用~ 東北工業大学 工学部 電気電子工学課程 教授 東北大学 大学院工学研究科ロボティクス専攻 客員教授 レイセンス 共同創業者・取締役・最高技術責任者 望山 真徳 氏	
		会場：西3ホール内 要調無料 / 事前登録不要	
		※法人格省略	
6/11 (木)	13:00-13:15	二光子重合(2PP)技術が拓く、次世代センサー設計の自由度 SUテクノロジ 開発・営業部 マネージャー 清水 謙太郎 氏	
	10:30-10:45	センサデバイスへのインクジェット技術活用事例のご紹介 SUテクノロジ 開発・営業部 マネージャー 田代 直樹 氏	
	11:30-12:00	最適な製造条件を探索するプロセスインフォマティクス アイクリスタル 代表取締役 高石 将輝 氏	
	14:00-14:30	プロセスインフォマティクスを圧倒的に加速するための生産技術DX アイクリスタル アプリケーション事業部 執行役員 アプリケーション事業部長 服部 優希 氏	

主催者企画 センシング体験コーナー

■Sensing Garden 協力:ジャパンディスプレイ様

センシングで作る新たな世界/Sense-Built Worlds

「触れる」が「動かす」に変わる。「こんなものまでセンサーに!？」驚きの未来を体験いただけるコーナーを新設し、来場者にデモ体験を行っていただきました。

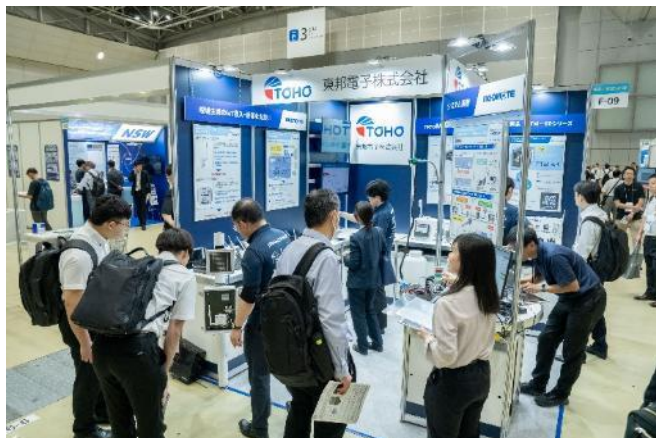
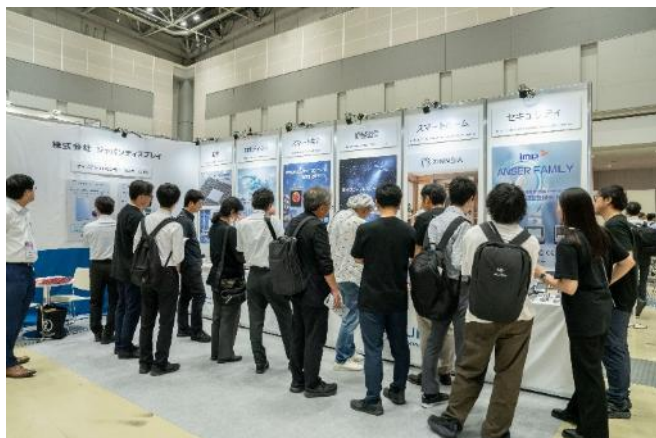
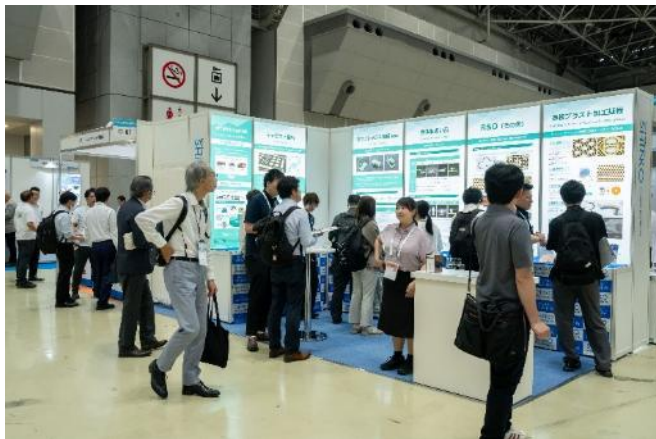
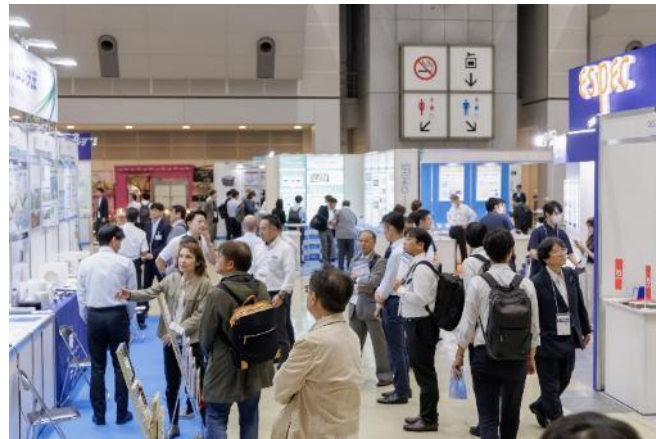


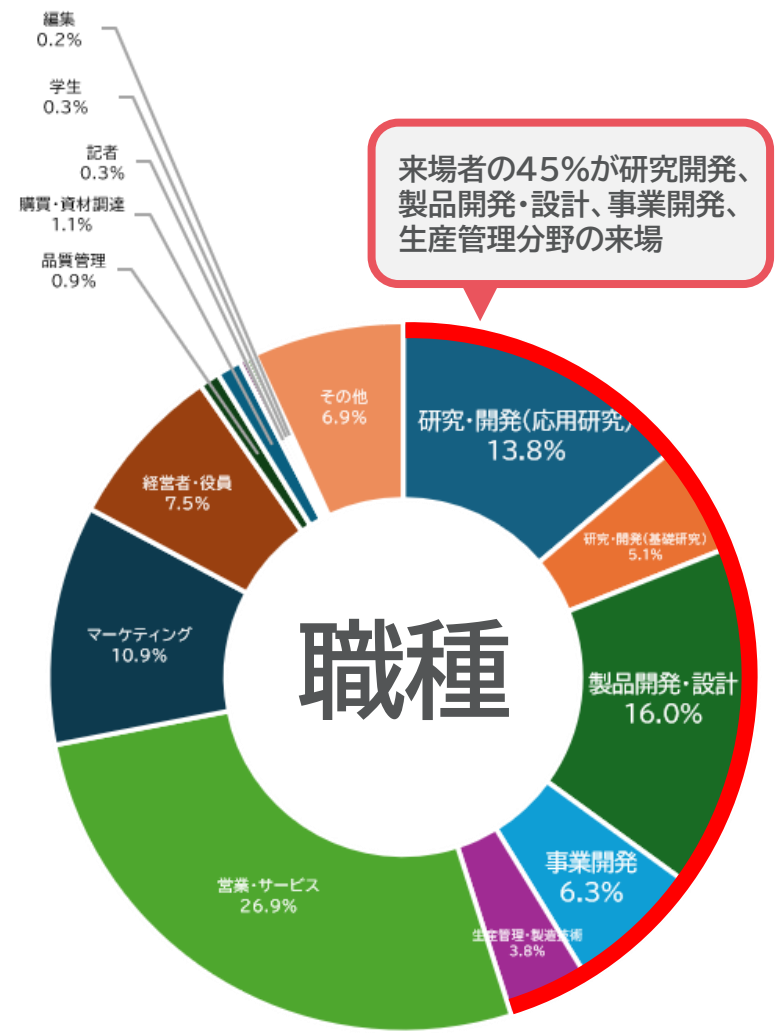
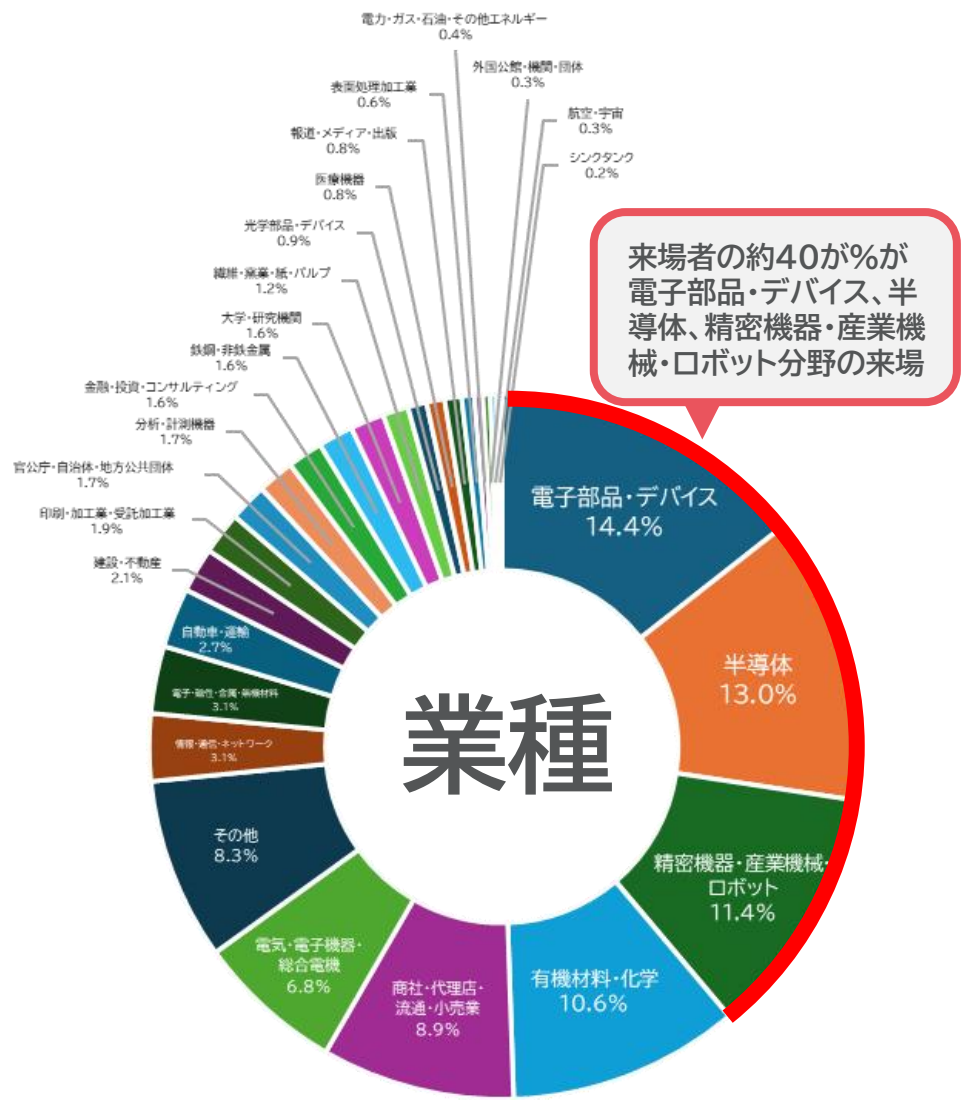
■ゴルフセンシング体験コーナー/匠の技センシングコーナー 協力:東北工業大学様

前回、反響の大きかったゴルフセンシングを今回も開催。ゴルフスイングで力のかけ方の可視化する体験コーナーを設置。また、熟練の技継承に繋がるセンシング技術を匠の技と称し、製造業のご来場者を中心に見学されました。



展示会ハイライト





■Smart Sensing/SEMISOL 事務局

(株)JTBコミュニケーションデザイン

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング

E-mail:smartsensing@jtbcom.co.jp